

一般社団法人 DLC 工業会  
2024 年度講演会

最新の半導体製造技術と DLC 膜の応用について講演会を開催します。半導体製造における基盤技術から最先端の応用技術まで、幅広いトピックをカバーします。専門知識を深めたい方や最新情報をキャッチアップしたい方は、ぜひご参加ください。

日 時： 2024 年 9 月 12 日 13:30~16:40 (受付 13:00~)

形式・場所：対面 (ナノテック株式会社会議室) +WEB

〒277-0874 千葉県柏市柏インター南 4 番地 6 ナノテクノプラザ

テーマ： 「半導体製造関連技術の最前線と DLC 膜の応用 ~前工程から後工程まで~」

定 員： 対面 20 名, WEB 100 名

参加費： 会員 3,300 円 (税込), 非会員 5,500 円 (税込)

協 賛： (一社) ニューダイヤモンドフォーラム

【プログラム】

司会：DLC 工業会 理事 平塚 傑工 氏

13:30~13:45 開会挨拶

DLC 工業会 会長 中森 秀樹 氏

[講 演] (対面および WEB)

(1) 13:50~14:20 「半導体製造の基盤技術と関連製品 ~洗浄技術と付帯機器~」

リックス(株) 生田 勝治 氏

(2) 14:20~14:50 「半導体製造とガスタータルソリューション」

(株) ウエキコーポレーション 伊東 祐介 氏

< 14:50~15:10 休 憩 >

(3) 15:10~15:50 「DLC 膜の半導体製造技術への応用」

(株) トッケン 平塚 傑工 氏

ナノテック(株) 中森 秀樹 氏

(4) 15:50~16:30 「半導体後工程における物理力評価及び試験装置」

(株) レスカ 竹内 光明 氏

16:30~16:40 閉会挨拶

DLC 工業会 理事 真田 博幸 氏

[懇親会] 16:50~18:50 (移動)

場 所：徳樹庵予定 (送迎バス予定：つくばエクスプレス「柏の葉キャンパス」駅)

会 費：6,600 円 (税込)

【申込方法】参加を希望される方は、以下のいずれかの方法にてお申し込みください。

① WEB フォーム

<https://forms.gle/NQh8CG2FuJU7BRXN6>

② 別紙の参加申込書 (Word) をご記入の上、電子メール添付にてご送付ください。

送信先：E-Mail：info@dlck.org (一般社団法人 DLC 工業会 宛)

※WEBにてお申込みいただいている場合は不要です。

E-mail : info@dlck.org  
(一社)DLC 工業会事務局 宛

2024 年 月 日

(一社) DLC 工業会 2024 年度講演会  
参加申込書

[講演会]	参加 ( 対面	WEB )	不参加
[懇親会]	参加	不参加	

講演会、懇親会は別の料金となりますので、全てに関して参加・不参加をご選択ください。

お名前：

ご所属・ご役職等：

ご連絡先（所属・所在地・電話・E-mail）：